

2019年3月期 第2四半期（2018年7月～9月） 東京エレクトロン 決算説明会

2018年10月31日

内容：

- 第2四半期 連結決算の概要 経理部長 笹川 謙
- 事業環境および業績予想修正 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第2四半期 連結決算の概要

2018年10月31日

笹川 謙
経理部長



FY2019 上期（2018年4月～9月）ハイライト

- 半期ベースで過去最高の売上と利益額*1を達成
 - SPE*2では、メモリが新規装置売上を牽引
 - FPD*3では、当社が強みを持つ第10.5世代パネル向け売上が堅調
- 納入済み装置は約67,000台に到達
 - FS*4売上は前年同期比+17%の1,393億円、安定的な収益を創出

*1 売上総利益・営業利益・親会社株主に帰属する当期純利益 *2 SPE：半導体製造装置 *3 FPD：フラットパネルディスプレイ製造装置 *4 FS：フィールドソリューション

損益状況（半期）

（億円）

| | FY2018 | | FY2019 | 対前年H1 増減率 | （ご参考） 4月25日発表の FY2019 H1予想 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|
| | H1 | H2 | H1 | | |
| 売上高 | 5,169 | 6,137 | 6,910 | +33.7% | 6,900 |
| SPE | 4,877 | 5,674 | 6,384 | +30.9% | 6,340 |
| FPD | 290 | 460 | 524 | +80.8% | 560 |
| 売上総利益 下段：売上総利益率 | 2,154 41.7% | 2,596 42.3% | 2,841 41.1% | +31.9% -0.6pts | 2,880 41.7% |
| 販管費 | 920 | 1,017 | 1,086 | +18.0% | 1,150 |
| 営業利益 下段：営業利益率 | 1,233 23.9% | 1,578 25.7% | 1,754 25.4% | +42.2% +1.5pts | 1,730 25.1% |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,223 | 1,529 | 1,811 | +48.1% | 1,730 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 906 | 1,137 | 1,352 | +49.2% | 1,280 |
| 研究開発費 | 460 | 510 | 573 | +24.5% | |
| 設備投資額 | 198 | 257 | 229 | +15.7% | |
| 減価償却費 | 90 | 115 | 107 | +18.8% | |

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況（四半期）

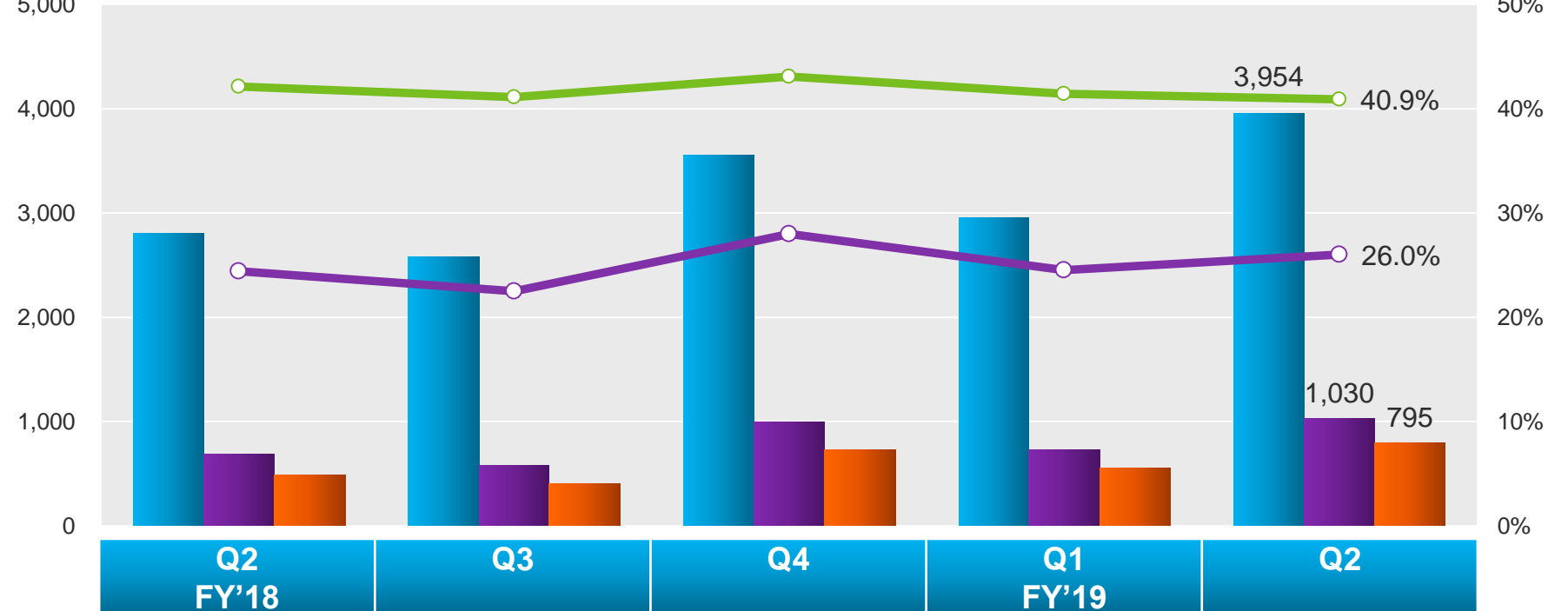
(億円)

| | FY2018 | | | FY2019 | | 対FY2019 Q1 増減率 |
|---------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------------|
| | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | |
| 売上高 | 2,805 | 2,577 | 3,559 | 2,955 | 3,954 | +33.8% |
| SPE | 2,657 | 2,414 | 3,260 | 2,804 | 3,580 | +27.7% |
| FPD | 147 | 162 | 297 | 151 | 373 | +147.2% |
| 売上総利益 | 1,182 | 1,060 | 1,535 | 1,224 | 1,616 | +32.0% |
| 下段：売上総利益率 | 42.1% | 41.1% | 43.1% | 41.4% | 40.9% | -0.5pts |
| 販管費 | 497 | 479 | 537 | 500 | 586 | +17.1% |
| 営業利益 | 685 | 580 | 997 | 724 | 1,030 | +42.2% |
| 下段：営業利益率 | 24.4% | 22.5% | 28.0% | 24.5% | 26.0% | +1.5pts |
| 税金等調整前当期純利益 | 671 | 573 | 956 | 752 | 1,058 | +40.8% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 494 | 407 | 729 | 557 | 795 | +42.7% |
| 研究開発費 | 248 | 239 | 270 | 261 | 312 | +19.4% |
| 設備投資額 | 117 | 137 | 120 | 96 | 132 | +36.7% |
| 減価償却費 | 47 | 55 | 60 | 50 | 56 | +11.1% |

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況 (四半期)

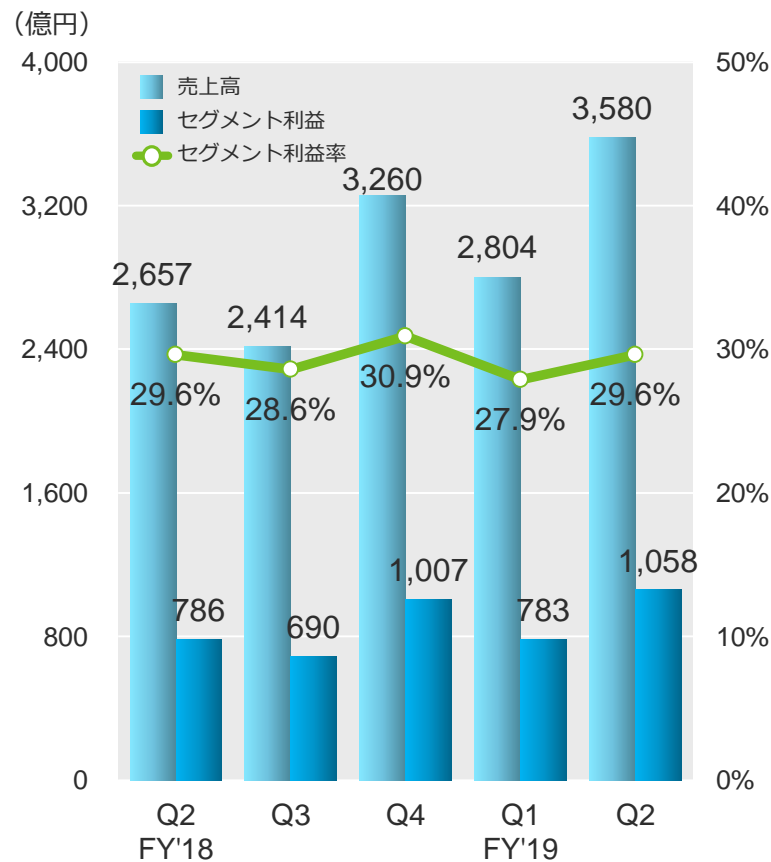
(億円)
5,000



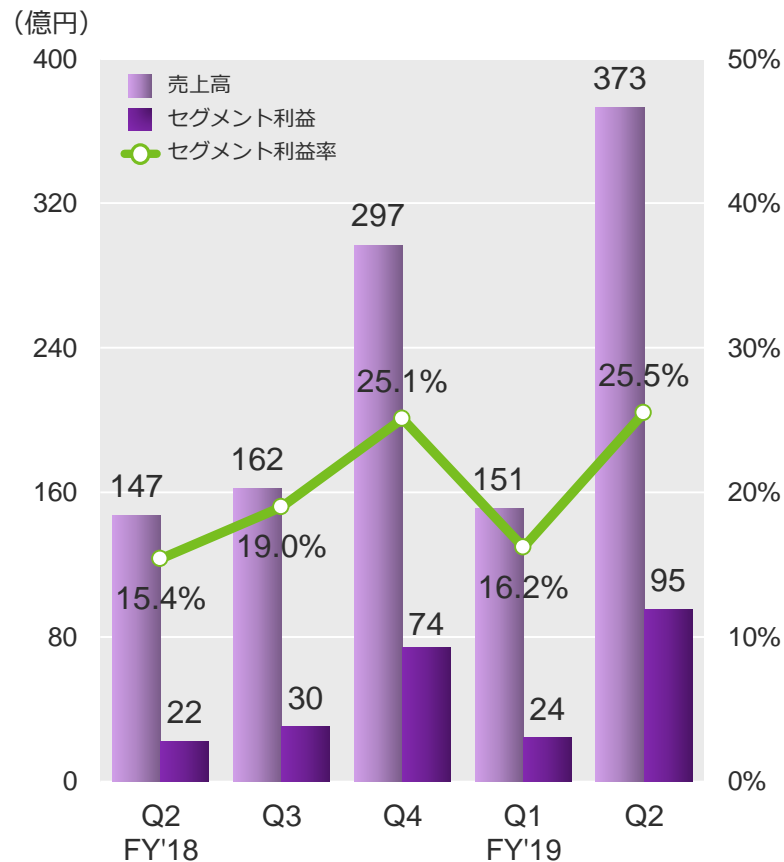
| | Q2 FY'18 | Q3 | Q4 | Q1 FY'19 | Q2 |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|
| ■ 売上高 | 2,805 | 2,577 | 3,559 | 2,955 | 3,954 |
| ■ 営業利益 | 685 | 580 | 997 | 724 | 1,030 |
| ■ 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 494 | 407 | 729 | 557 | 795 |
| ○ 売上総利益率 | 42.1% | 41.1% | 43.1% | 41.4% | 40.9% |
| ○ 営業利益率 | 24.4% | 22.5% | 28.0% | 24.5% | 26.0% |

セグメント情報（四半期）

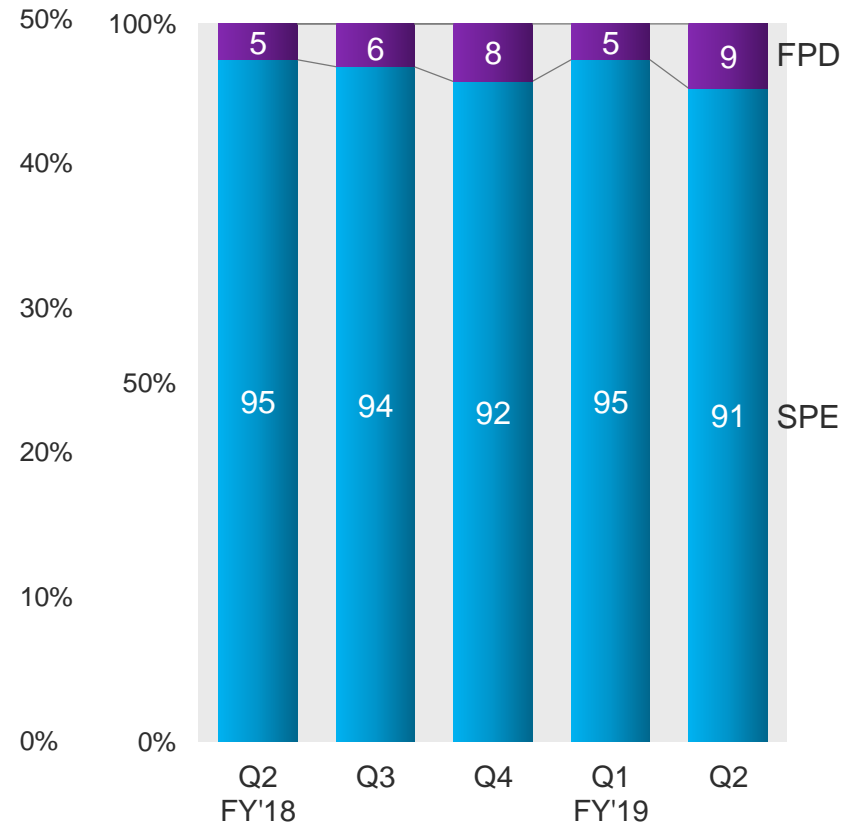
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）

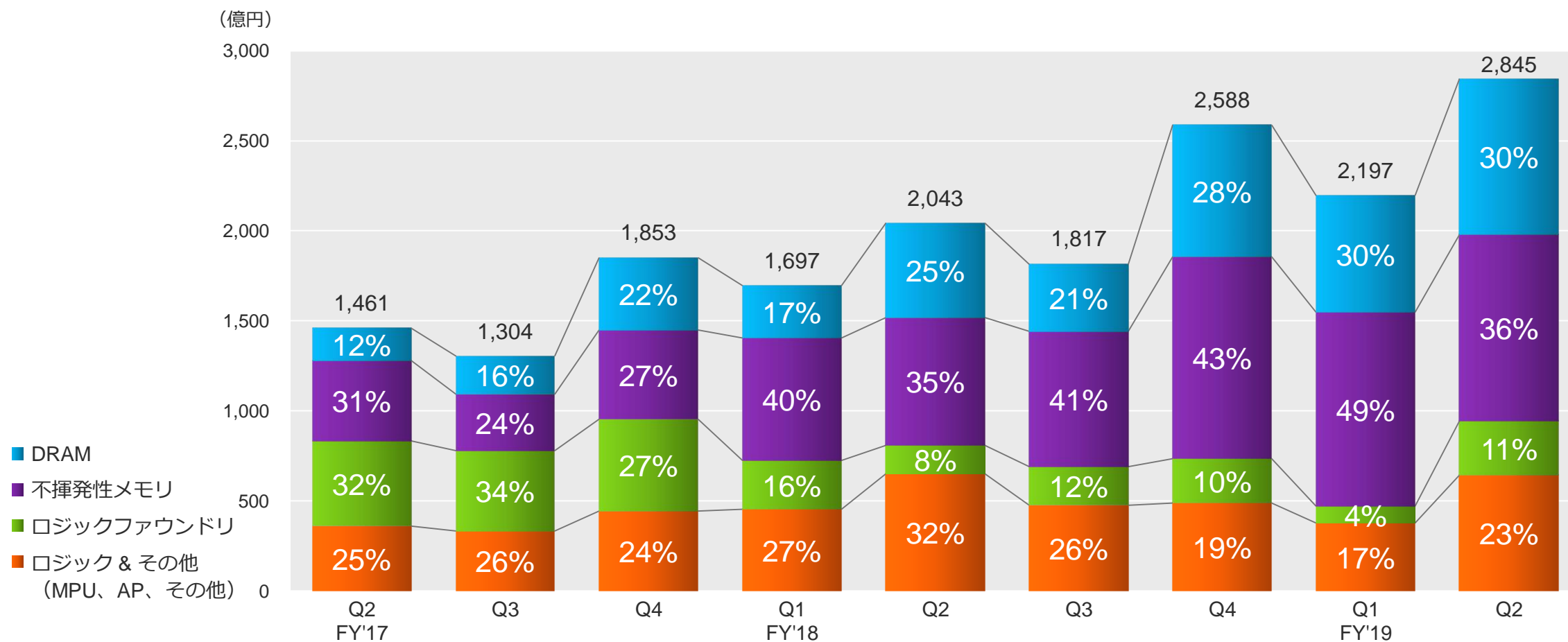


売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

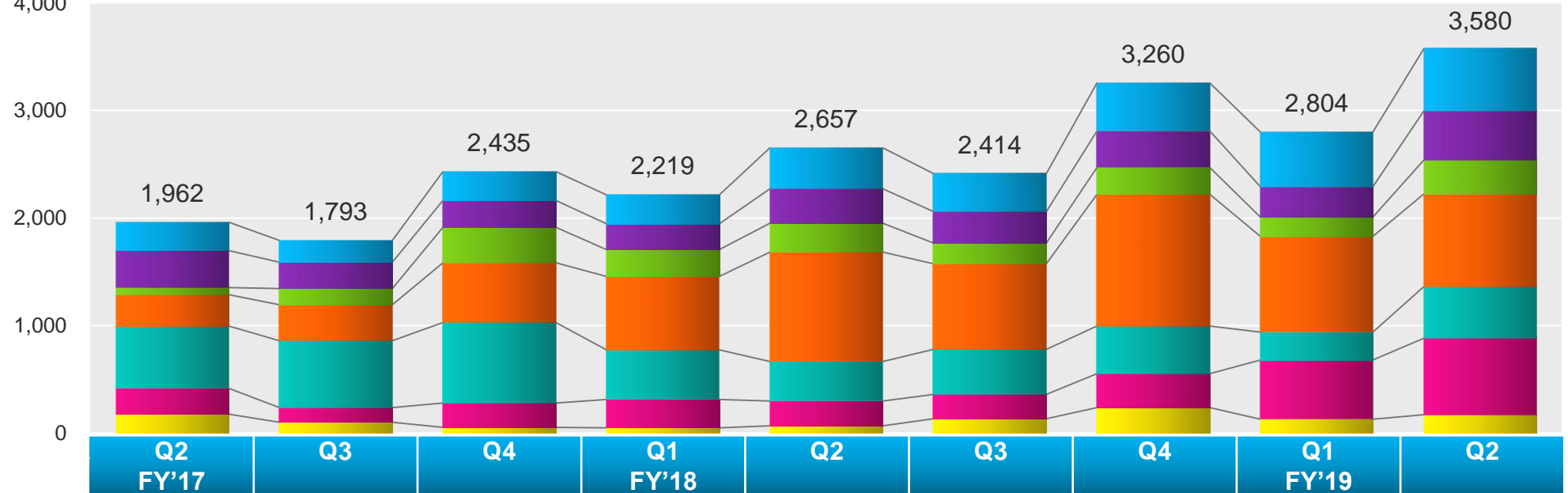
SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

SPE部門 地域別売上高 (四半期)

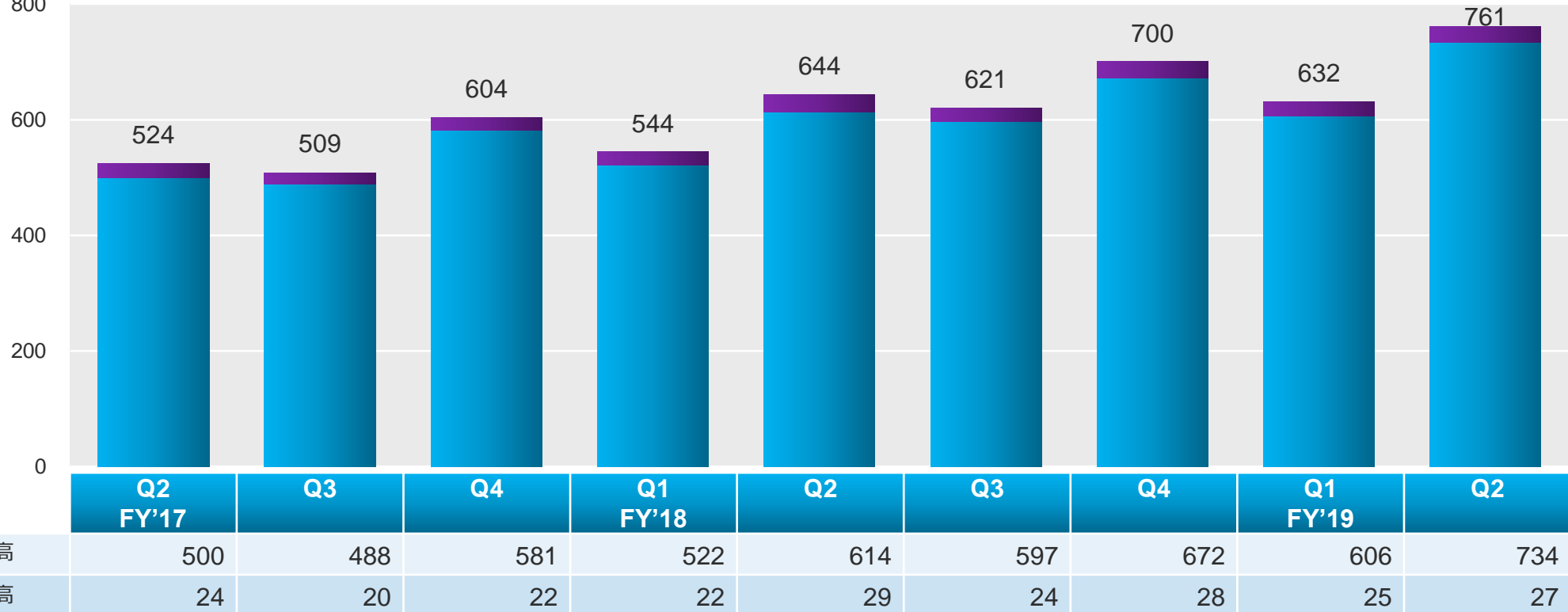
(億円)
4,000



| | Q2 FY'17 | Q3 | Q4 | Q1 FY'18 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 FY'19 | Q2 |
|---------|----------|-----|-----|----------|-------|-----|-------|----------|-----|
| 日本 | 264 | 203 | 266 | 267 | 384 | 351 | 451 | 511 | 580 |
| 北米 | 344 | 246 | 254 | 240 | 320 | 291 | 339 | 284 | 459 |
| 欧州 | 66 | 150 | 329 | 253 | 269 | 196 | 250 | 177 | 313 |
| 韓国 | 290 | 333 | 555 | 683 | 1,017 | 794 | 1,223 | 889 | 865 |
| 台湾 | 582 | 623 | 747 | 458 | 366 | 421 | 443 | 263 | 480 |
| 中国 | 240 | 137 | 227 | 267 | 230 | 226 | 318 | 549 | 713 |
| 東南アジア・他 | 173 | 98 | 53 | 46 | 67 | 132 | 234 | 127 | 168 |

フィールドソリューション売上高（四半期）

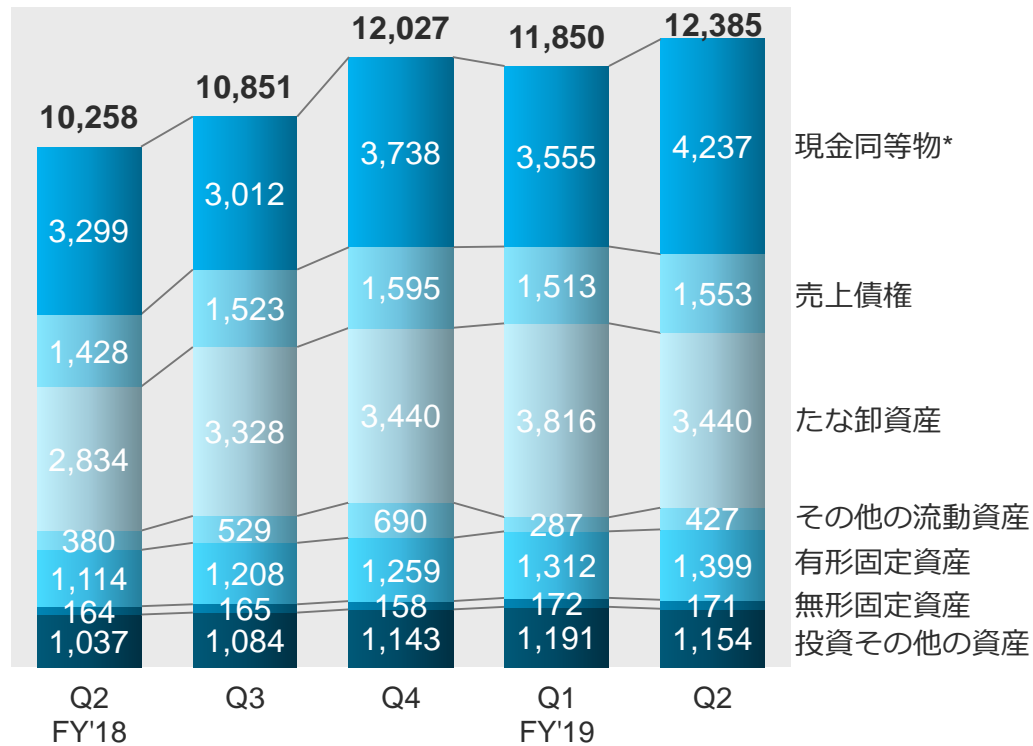
(億円)



貸借対照表（四半期）

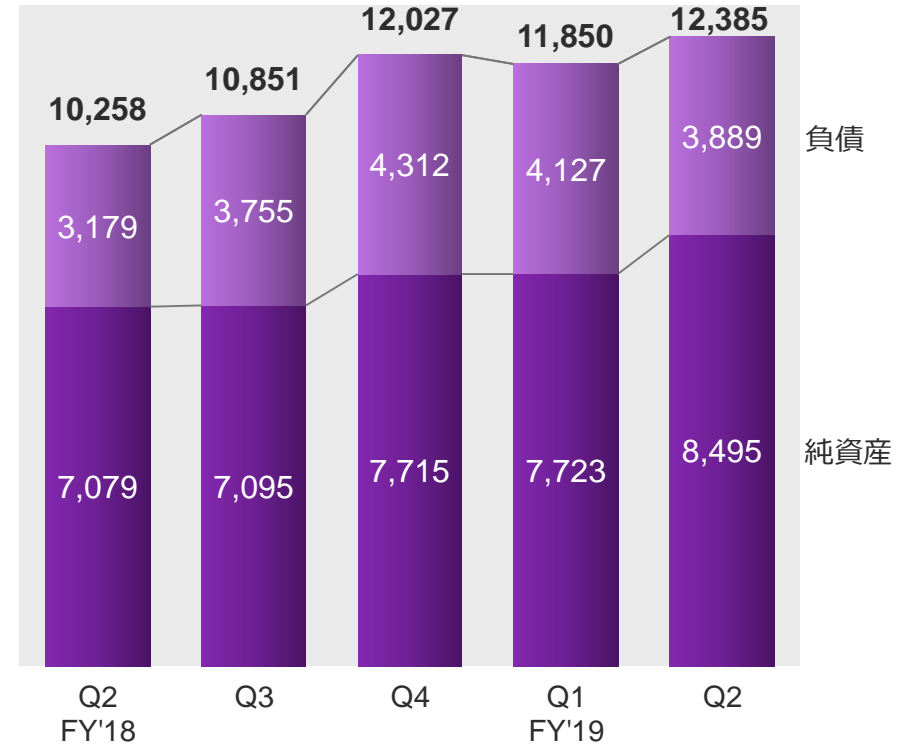
資産

(億円)



負債・純資産

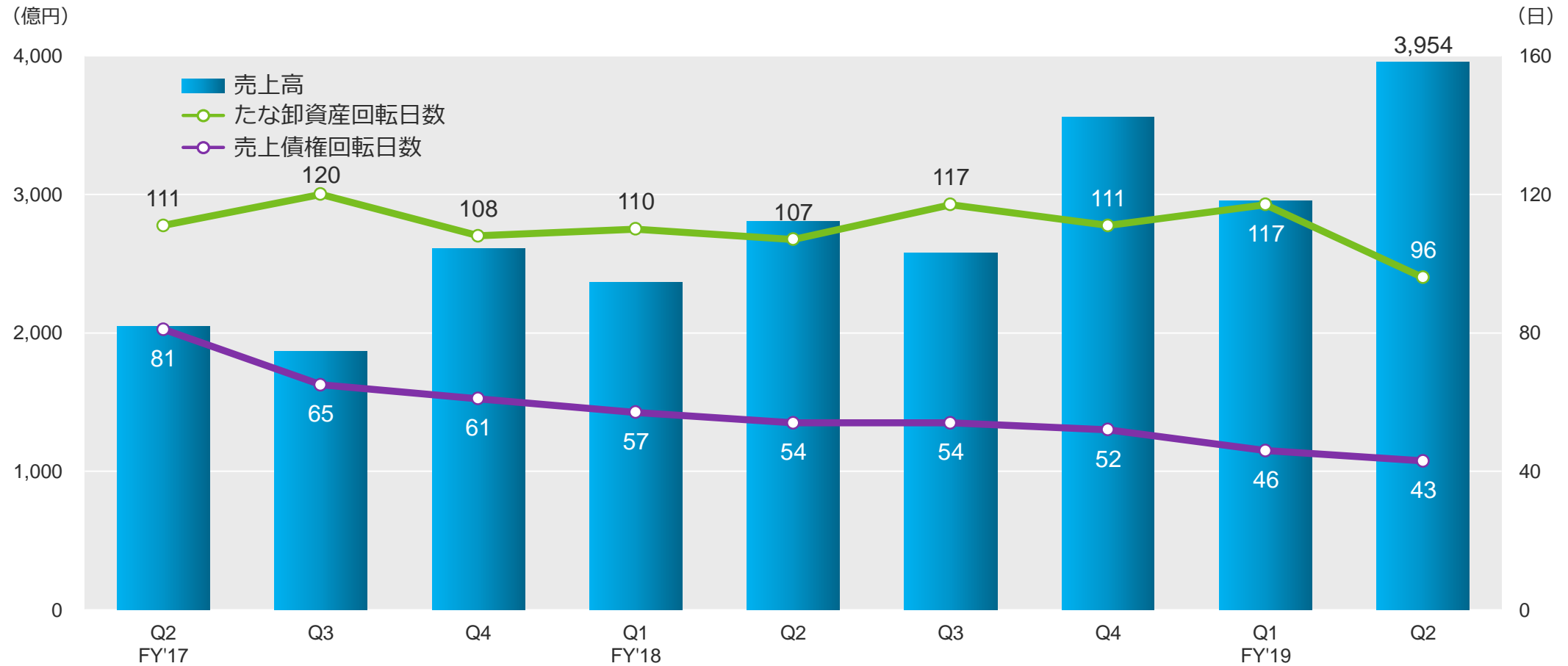
(億円)



* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

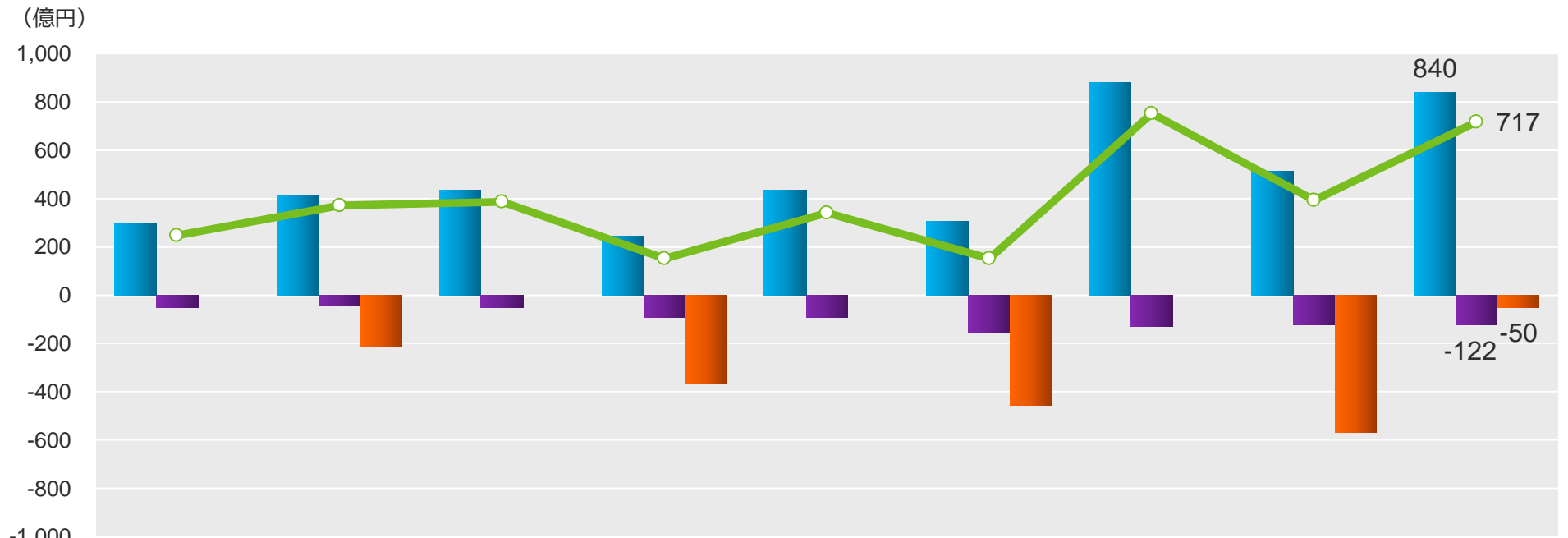
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等をFY2019 Q1会計期間の期首から適用しており、FY2018の実績については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しています。

たな卸資産・売上債権の回転日数（四半期）



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー（四半期）



| | Q2 FY'17 | Q3 | Q4 | Q1 FY'18 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 FY'19 | Q2 |
|------------------|-------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| ■ 営業キャッシュ・フロー | 298 | 413 | 436 | 244 | 434 | 304 | 881 | 514 | 840 |
| ■ 投資キャッシュ・フロー*1 | -49 | -41 | -49 | -93 | -94 | -152 | -128 | -121 | -122 |
| ■ 財務キャッシュ・フロー | 0 | -210 | -0 | -368 | -0 | -457 | -0 | -569 | -50 |
| ○ フリーキャッシュ・フロー*2 | 248 | 371 | 387 | 151 | 340 | 151 | 753 | 393 | 717 |
| 手元資金残高*3 | 2,556 | 2,772 | 3,153 | 2,946 | 3,299 | 3,012 | 3,738 | 3,555 | 4,237 |

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

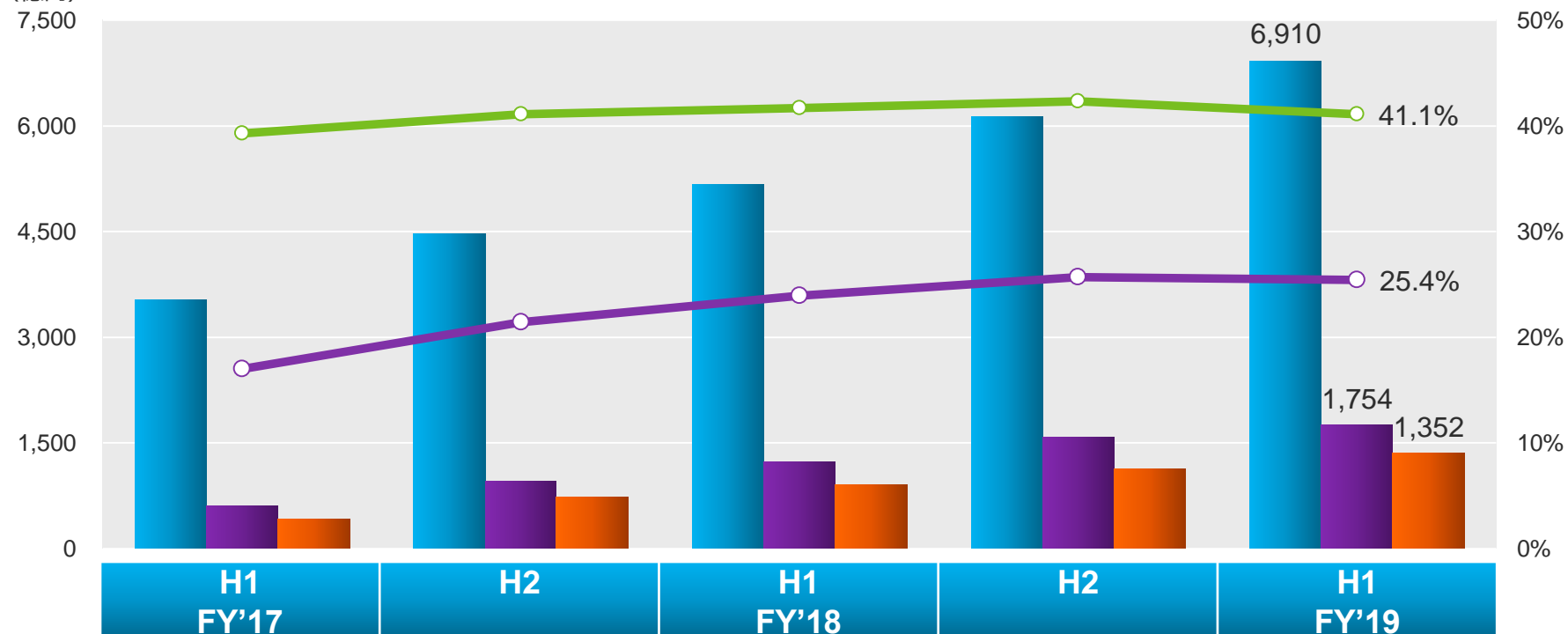
*2 フリーキャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー（満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く）

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

Appendix

損益状況（半期）

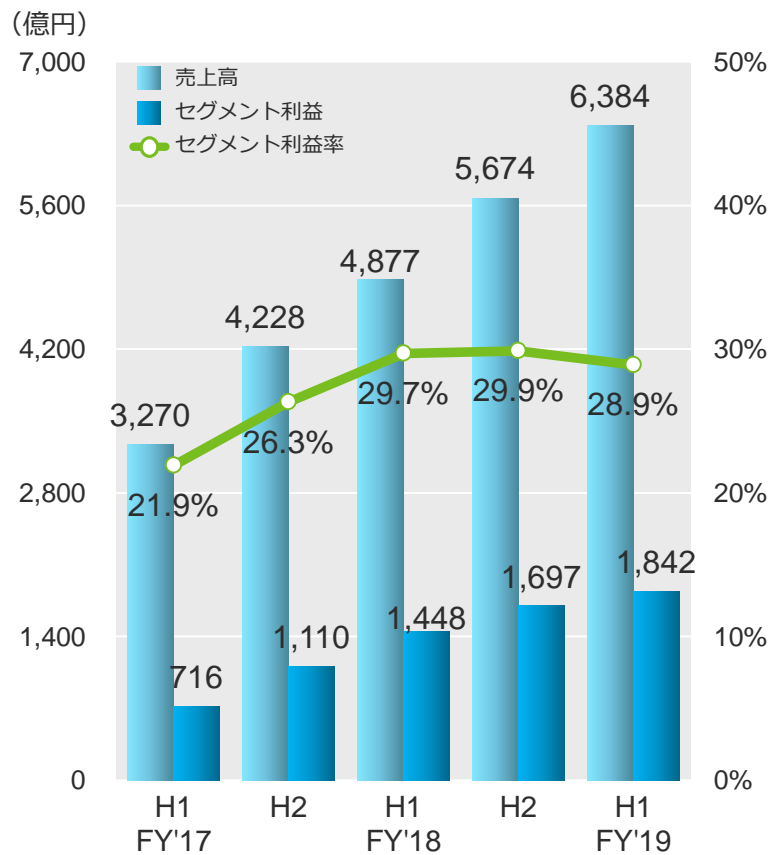
(億円)
7,500



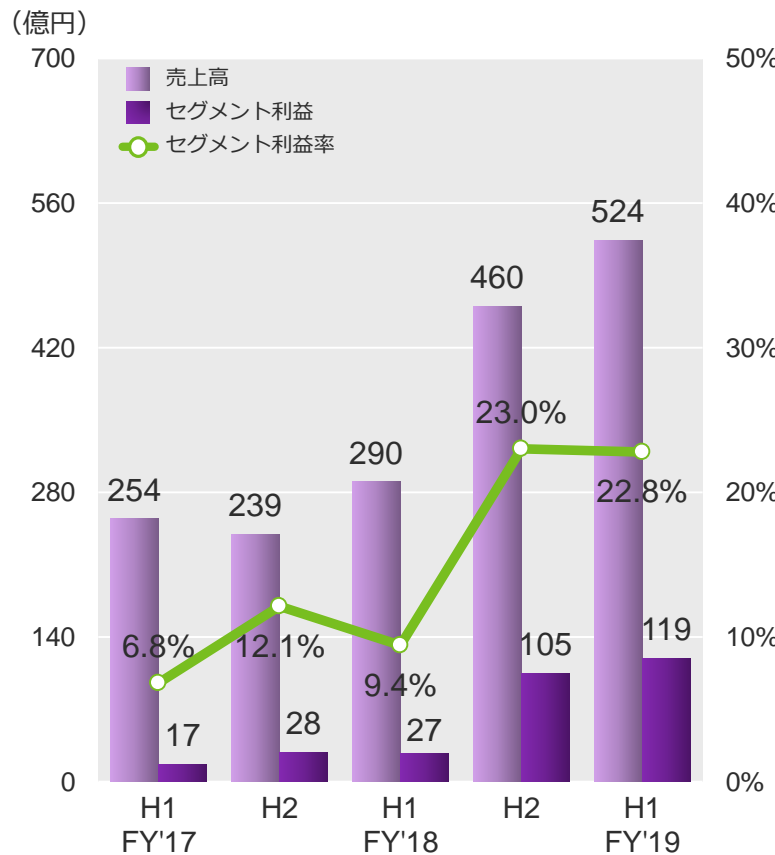
| | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ■ 売上高 | 3,527 | 4,469 | 5,169 | 6,137 | 6,910 |
| ■ 営業利益 | 600 | 956 | 1,233 | 1,578 | 1,754 |
| ■ 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 419 | 732 | 906 | 1,137 | 1,352 |
| ○ 売上総利益率 | 39.3% | 41.1% | 41.7% | 42.3% | 41.1% |
| ○ 営業利益率 | 17.0% | 21.4% | 23.9% | 25.7% | 25.4% |

セグメント情報（半期）

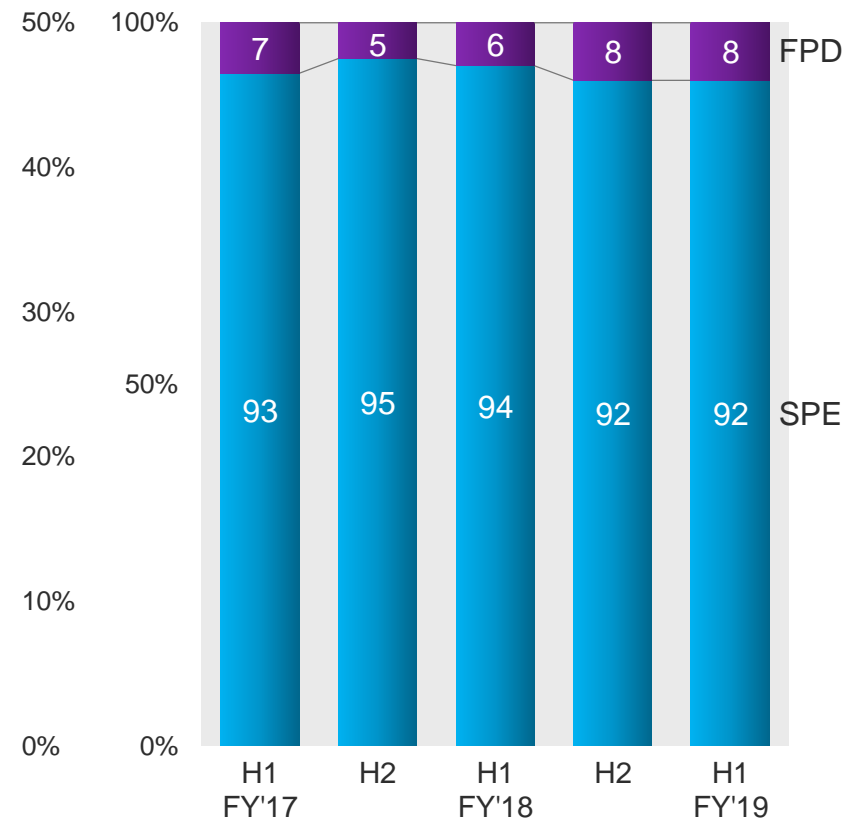
SPE（半導体製造装置）



FPD（フラットパネルディスプレイ製造装置）



売上構成比率

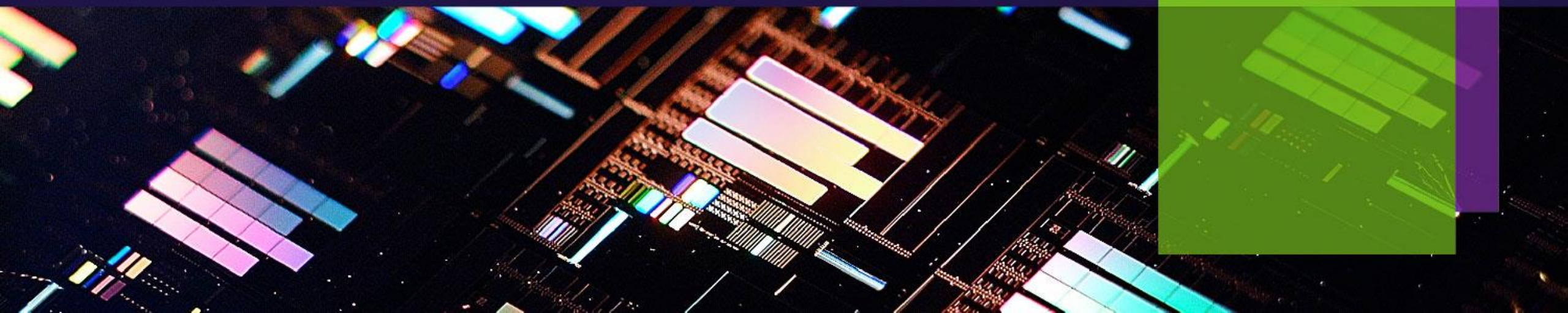


1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

事業環境および業績予想修正

2018年10月31日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2018年10月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2018の投資額は、旺盛なメモリ向け需要に牽引され、前年比5～10%程度の成長を見込む

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2018の装置需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資は調整も、第10.5世代向けが大きく拡大し、前年同等の高水準の投資が継続

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が継続

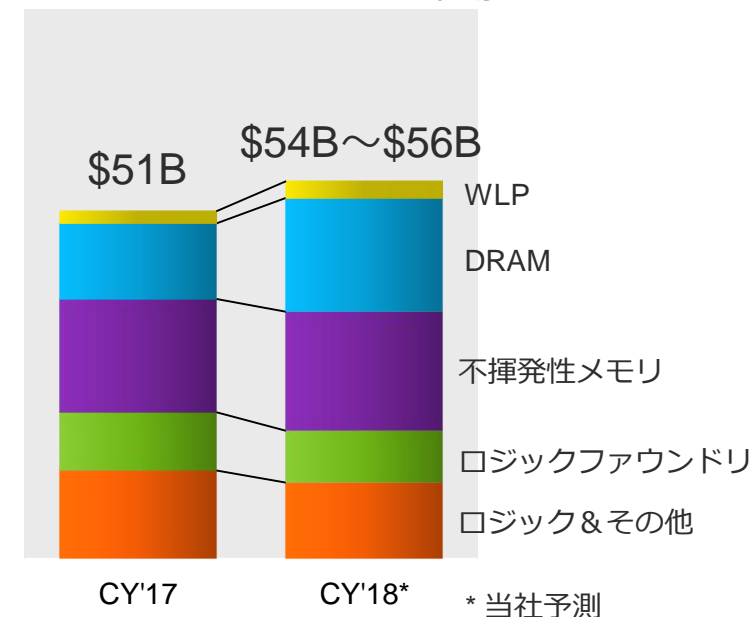
*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2018 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- DRAM：前年比50～55%増加
 - 設備投資：投資額の7割が新規工場向け、また8割が1X/1Ynm世代向け
 - 牽引役：サーバの平均搭載容量は前年比35%増加
 - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- 不揮発性メモリ：前年同水準～5%増加
 - 設備投資：最先端の9X層数世代向けが5割
 - 牽引役：データセンタ・PC向けSSD需要の拡大
 - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：前年比10～15%減少
 - 設備投資：10nm以細の世代向けが5割
 - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

アプリケーション別WFE市場



FY2019 SPE事業の進捗

- 戦略製品の売上拡大。注力分野（エッチング、成膜、洗浄）における次世代のPOR*の獲得も進む
- プロセスインテグレーションの提案がPOR拡大に貢献
 - クリティカルモジュールにおいて、エッチング、洗浄、成膜の相互最適化によりデバイス性能と歩留を向上
- IoTアプリケーションの拡大と納入済み装置台数の増加により、FS事業の収益拡大
- 宮城工場（エッチング装置）の拡張
 - 新開発棟の竣工（10月）
 - 新生産ラインの稼働（11月予定）

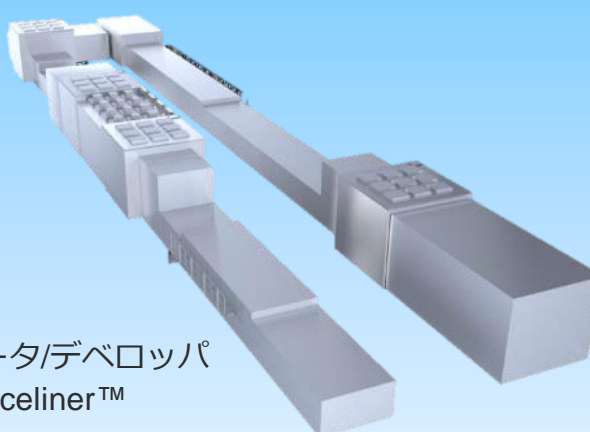


東京エレクトロン宮城

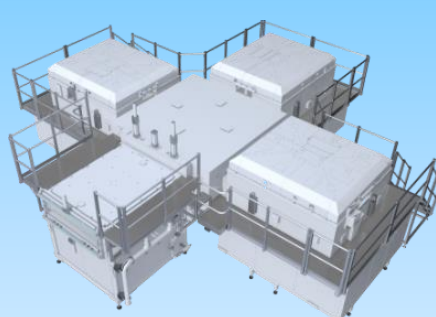
事業戦略は計画通り進捗、次世代向け技術で収益拡大

FY2019 FPD事業の進捗


- 第10.5世代向け装置の拡販。売上・利益率向上に貢献
- 新製品の販売開始
 - 高精細FPD向け第10.5世代プラズマエッチング装置 Impressio™ 3300 PICP*™
 - 有機ELディスプレイ向け第4.5世代インクジェット描画装置 Elius™ 1000



FPDコータ/デベロッパ
Excelsiner™



FPDプラズマ
エッチング/アッシング装置
Impressio™



有機ELディスプレイ製造用
インクジェット描画装置 Elius™

過去最高の通期売上と計画通りの利益率向上を見込む

FY2019 業績予想修正

FY2019 業績予想修正

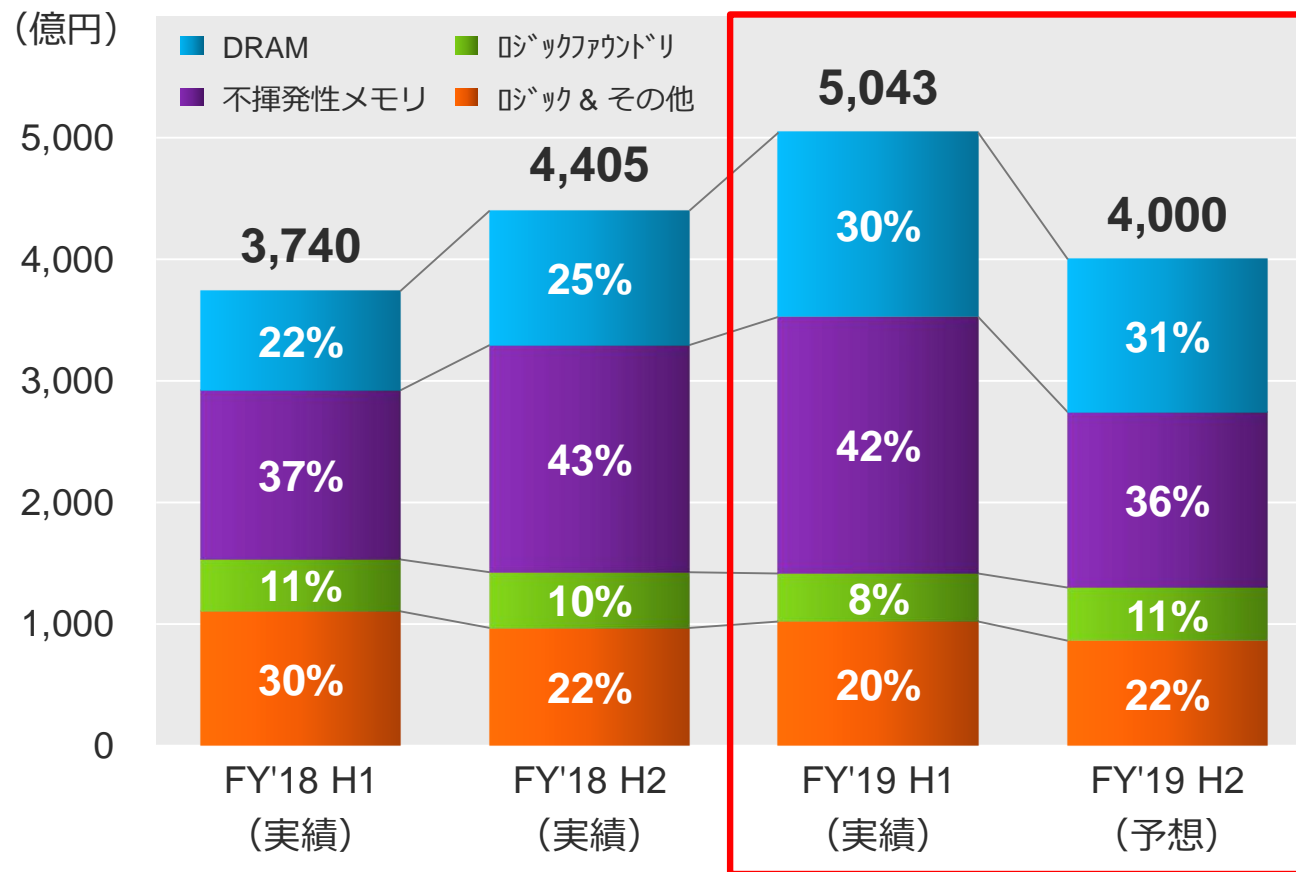
(億円)

| | FY2018 (実績) | FY2019 (予想) | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | H1 | H2 | | 通期 | | 通期 対前年増減 |
| | | 実績 | 新予想 | 修正額*1 | 新予想 | 修正額*1 | |
| 売上高 | 11,307 | 6,910 | 5,889 | -1,210 | 12,800 | -1,200 | +13.2% |
| SPE | 10,552 | 6,384 | 5,313 | -1,226 | 11,698 | -1,182 | +10.9% |
| FPD | 750 | 524 | 575 | +15 | 1,100 | -20 | +46.5% |
| 売上総利益 下段：売上総利益率 | 4,750 42.0% | 2,841 41.1% | 2,438 41.4% | -661 -2.3pts | 5,280 41.3% | -700 -1.4pts | +529 -0.7pts |
| 販管費 | 1,938 | 1,086 | 1,103 | -66 | 2,190 | -130 | +251 |
| 営業利益 下段：営業利益率 | 2,811 24.9% | 1,754 25.4% | 1,335 22.7% | -594 -4.5pts | 3,090 24.1% | -570 -2.0pts | +278 -0.8pts |
| 税前利益 | 2,752 | 1,811 | 1,338 | -591 | 3,150 | -510 | +397 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,043 | 1,352 | 1,017 | -402 | 2,370 | -330 | +326 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 1,245.48 | 824.70 | - | - | 1,445.20 | -200.00 | +199.72 |

市場拡大とシェア向上により、3期連続の過去最高益*2を見込む

FY2019 SPE部門 新規装置売上予想

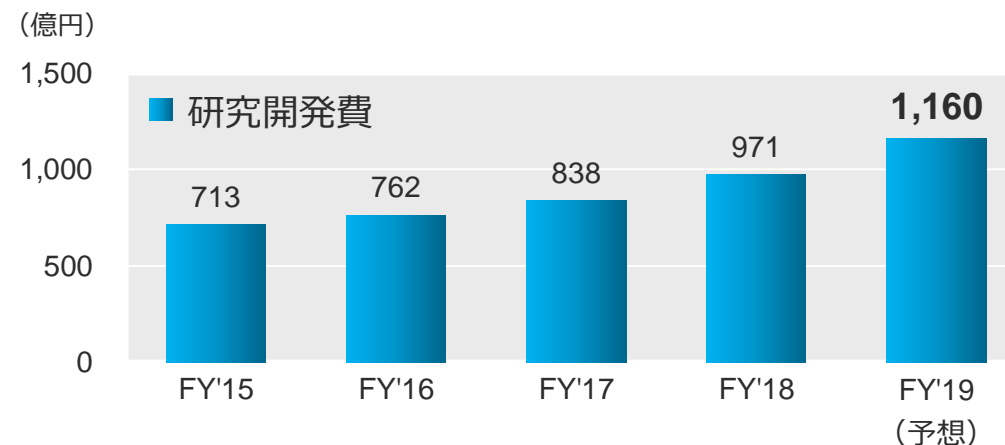
アプリケーション別売上構成比



下期もメモリ向け売上が7割を占める

FY2019 研究開発費・設備投資計画

- 開発費 1,160億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 510億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 260億円



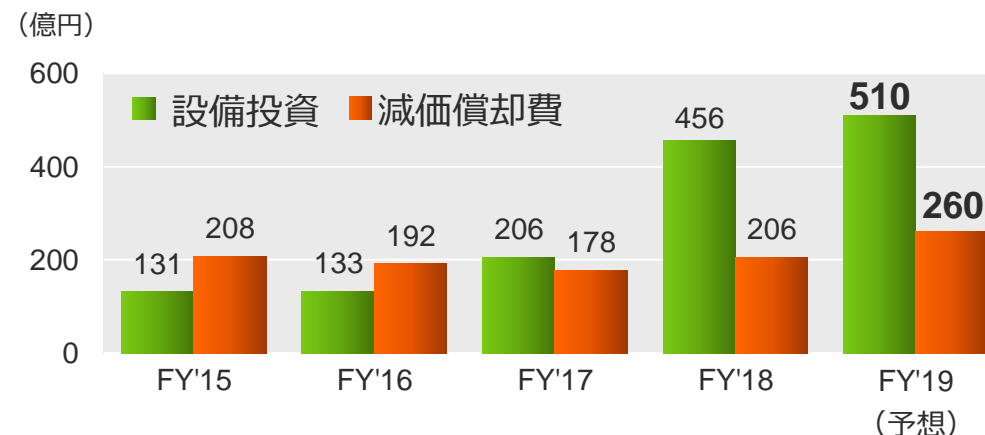
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士川市：建設費約130億円
(2019年1月着工、2020年4月竣工予定)

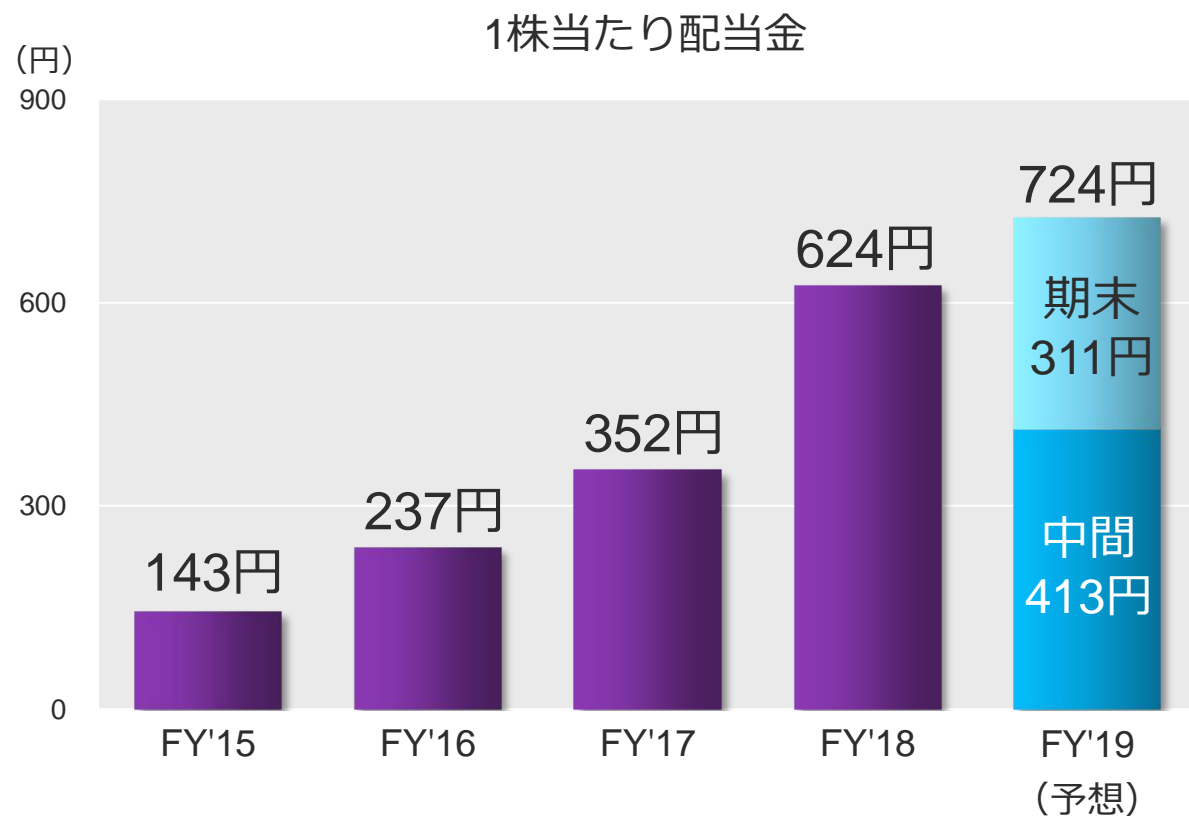


岩手県奥州市：建設費約130億円
(2018年10月着工、2019年9月竣工予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2019 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比16%増加の724円を予定

TEL™

TOKYO ELECTRON